

低温硬化性ベンゾオキサジンモノマー

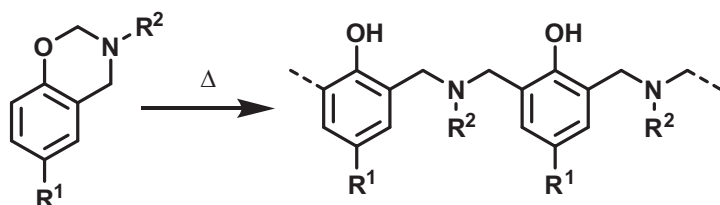
開発品

Benzoxazine Monomers with Low Temperature Curable.

低温硬化性、高耐熱性、低粘度なベンゾオキサジンモノマーをご提案致します。

We propose Benzoxazine(BOZ) monomers with low-temperature curability, high heat resistance, low-viscosity.

概要 Outline



低温硬化

low-temperature curability

高耐熱性

high heat resistance

低粘度

low-viscosity

- 低温硬化性、耐熱性、低粘度などの特性をバランスよく兼ね備えております。

Our BOZ monomers have low-temperature curability, high heat resistance and low viscosity.

- ビスマレイミド (BMI) やエポキシとの配合により、高耐熱性樹脂が得られます。(図1参照)

By blending our BOZ with BMI or epoxy, it is also possible to enhance the resin Tg more.

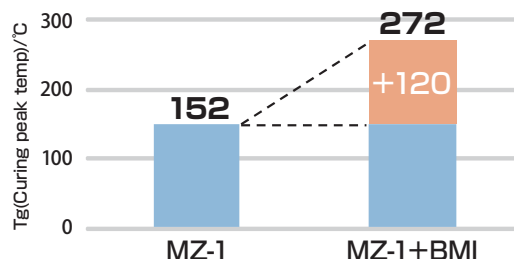


図1. BMIとの配合による相乗効果 (MZ-1での実績例)
The high heat resistance of MZ-1 by mixing BMI

各種 BOZ の特性 Characteristics of various BOZ

| 製品名 Product name | 一般的なBOZ conventional BOZ | LA-1 高耐熱グレード high heat resistance | MZ-1 低温硬化グレード low-temperature curing | MZ-3 特殊グレード Special | AZ-2 特殊硬化グレード Special curing |
|---------------------------------|-----------------------------|---|--|--|---|
| 硬化発熱温度 Curing peak temp. | 230 | 227 | 187 | 210 | 209 |
| Tg/°C Glass transition temp. | 222 | 243 | 152 | 205 | 165 |
| 粘度/Pa·S Viscosity | 11.9 | 1.9 | 3.3 | 低誘電+接着性期待 Expect low dielectric constant + high adhesiveness | 熱+ラジカル硬化 Thermosetting + radical polymerization |

用途例 Possible applications



半導体封止材
MOLDING COMPOUNDS



接着剤
ADHESIVES